

財團法人國家實驗研究院 函

機關地址：300091新竹市科學園區展業一路26號

聯絡人：羅愛雁

電話：03-5773693分機7769

電子信箱：0508364@niar.org.tw

受文者：國立成功大學研發處

發文日期：中華民國114年10月3日

發文字號：國研授半導體企字第1141301461號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件_2026年徵案計畫線上說明會公告(attch1 1141301461-0-0.pdf)

主旨：本院台灣半導體研究中心（以下簡稱本中心）「115年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心(TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫-線上說明會」即日起至114年10月7日受理報名，請惠予轉知貴校半導體相關科系研究團隊踴躍報名，請查照。

說明：

- 一、為促進台捷雙方合作交流，本院台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。
- 二、本計畫之執行期程自決標日起至115年11月20日。
- 三、線上說明會時間為114年10月9日(四) 16:00-18:00 (GMT+8)。
- 四、關於線上說明會的報名時間、報名網址、檔案上傳方式、研究主題領域、補助計畫內容及雙邊團隊媒合平台等，請詳附件TSRI-CTU JRC 2026年徵案計畫線上說明會公告或參考本中心官網之最新消息：
https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon_deta



i l . j s p ?
newsId=2025092501&kindName=Activities&kindId=I0002

，歡迎有意願了解或參與徵案的教授們踴躍報名線上說明會。

五、相關線上說明會疑問，請洽：03-5773693 #7779(葉先生)
#7170(江小姐)。

正本：大同大學研發處、大葉大學研發處、中華大學學校財團法人中華大學研發處、
中華學校財團法人中華科技大學研發處、元智大學研發處、明志科技大學研發處、
長庚大學研發處、國立中山大學研發處、國立中央大學研發處、國立中正大學研發處、
國立中興大學研發處、國立成功大學研發處、國立東華大學研發處、國立虎尾科技大學研發處、
國立屏東科技大學研發處、國立政治大學研發處、國立高雄大學研發處、國立高雄師範大學研發處、
國立清華大學研發處、國立雲林科技大學研發處、國立勤益科技大學研發處、國立嘉義大學研發處、
國立彰化師範大學研發處、國立暨南國際大學研發處、國立臺中科技大學研發處、國立臺中教育大學研發處、
國立臺北大學研發處、國立臺北科技大學研發處、國立臺北教育大學研發處、國立臺南大學研發處、
國立臺灣大學研發處、國立臺灣科技大學研發處、國立臺灣師範大學研發處、國立臺灣海洋大學研發處、
崑山科技大學研發處、義守大學研發處、臺北市立大學研發處、龍華科技大學研發處、淡江大學學校財團法人淡江大學研發處、
輔仁大學學校財團法人輔仁大學研發處、靜宜大學研發處、中國文化大學研發處、逢甲大學研發處、
中原大學研發處、玄奘大學研發處、明新學校財團法人明新科技大學研發處、東吳大學研發處、東海大學研發處、
南臺學校財團法人南臺科技大學研發處、城市學校財團法人臺北城市科技大學研發處、國立金門大學研發處、
國立高雄科技大學研發處、國立陽明交通大學研發處、國立聯合大學研發處、國防大學研發處

副本：114/10/07
08:27:24

院長 蔡宏營

TSRI-CTU JRC 2026年徵案計畫

線上說明會公告

2025.09

本中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。

本徵案計畫旨在透過學術合作與本中心服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，並促進雙邊科研資源與優勢共享。本案之申請團隊須為台方大專院校與CTU教授共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人為申請者，在期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。徵案之研究主題包含晶片設計領域以及晶片製造領域。

因配合雙方內部作業流程，將於2025年12月19日確認審查獲選名單，入選團隊將會進行限制性招標，計畫期程自決標日起，於7月3日前繳交期中查驗報告，並於11月20日前繳交期末驗收報告，計畫截止日為2026年11月20日。

本中心預計於2025年10月9日(四)舉辦線上說明會，並邀請有意願參與徵案的教授或其研究團隊所推派的研究生在說明會中簡短介紹其研究主題，相關說明如下：

一、線上說明會時間：2025年10月9日(四) 16:00-18:00 (GMT+8)

二、線上說明會報名時間：即日起至2025年10月7日(二) 23:59 (GMT+8)

三、線上說明會報名網址：<https://forms.gle/XvKy41vhMfj6evDt8>

四、線上說明會檔案上傳方式：

請有意於線上說明會簡要介紹研究主題的教授或研究生，透過上方報名連結上傳約一至兩分鐘的投影片檔案。

五、研究主題領域：

1. 晶片設計領域：Analog Design, Digital Design, MEMS Sensors, Silicon Photonics 及其他設計領域相關主題
2. 晶片製造領域：Semiconductor Manufacturing Technology, Technology Computer-Aided Design (TCAD) 及其他製造領域相關主題

六、補助計畫內容：

1. 每件計畫補助研究經費最高新臺幣壹佰玖拾萬元。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之TSRI晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片

實作發表。

七、雙邊團隊媒合平台：

1. 請有意參與研究的團隊進入下方連結網址進行研究主題與聯絡資訊的填寫，以利雙邊團隊媒合：<https://reurl.cc/GNvzxD>
2. 請有意參與研究的團隊進入下方連結網址上傳研究領域介紹投影片檔案，以利雙邊團隊媒合：<https://reurl.cc/6qMp05>

八、聯繫窗口：



聯絡電話：03-5773693 #7779(葉先生) #7170(江小姐)

E-mail：tsri.ctu_jrc@niar.org.tw